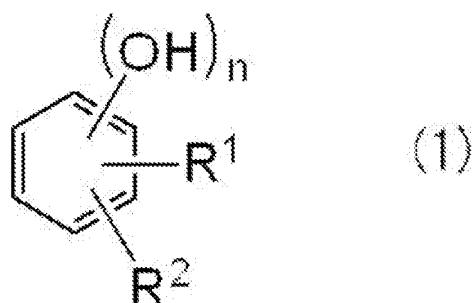


請求の範囲

〔請求項1〕 エポキシ樹脂と硬化剤とを含み、前記硬化剤は、下記一般式（1）で表されるフェノール化合物に由来する構造単位を含むフェノールノボラック樹脂を含む、硬化性樹脂組成物。

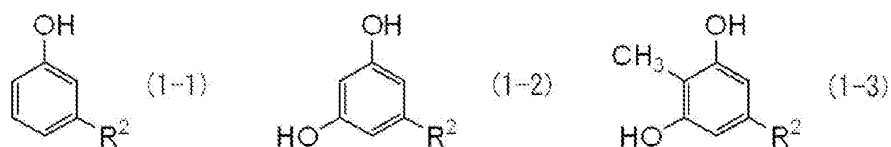
〔化1〕



（一般式（1）において、 R^1 は水素原子又はメチル基を表し、 R^2 は炭素数10～18の脂肪族炭化水素基を表し、 n は1又は2の整数である。）

〔請求項2〕 前記フェノールノボラック樹脂が、前記一般式（1）で表されるフェノール化合物に由来する構造単位として下記一般式（1-1）～一般式（1-3）で表されるフェノール化合物に由来する構造単位の少なくともひとつを含む、請求項1に記載の硬化性樹脂組成物。

〔化2〕



（一般式（1-1）～一般式（1-3）において、 R^2 は一般式（1）における R^2 と同義である。）

〔請求項3〕 前記フェノールノボラック樹脂が、前記一般式（1）で表されるフェノール化合物以外のフェノール化合物に由来する構造単位をさらに

含む、請求項 1 又は請求項 2 に記載の硬化性樹脂組成物。

[請求項4] 前記硬化剤が、前記一般式（1）で表されるフェノール化合物に由来する構造単位を含むフェノールノボラック樹脂以外の硬化剤をさらに含む、請求項 1 ～請求項 3 のいずれか 1 項に記載の硬化性樹脂組成物。

[請求項5] 電子部品装置の封止材として用いるための、請求項 1 ～請求項 4 のいずれか 1 項に記載の硬化性樹脂組成物。

[請求項6] 素子と、前記素子を封止する請求項 1 ～請求項 5 のいずれか 1 項に記載の硬化性樹脂組成物の硬化物と、を備える電子部品装置。